

产品装配 - 产品装配/拆卸/更换/修复 #1455

第二套一体化基站的3.5G RU拆壳

2023-12-07 13:28 - 马超

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-07
指派给:	祁彬彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
将第二套一体化基站的3.5G RU的板卡从RU模块壳中拆下来，再安装到原3.5G大功率RU外壳中。			

历史记录

#1 - 2023-12-07 18:04 - 祁彬彬

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成，交付给解决方案部。

#2 - 2023-12-07 18:04 - 祁彬彬

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2023-12-07 18:04 - 祁彬彬

- 状态 从 进行中 变更为 已解决